

순번

276

기술명

# 반도체 제조 공정을 위한 전구체의 실시간 증기압 측정 시스템 및 이를 이용한 방법

- 특허 번호 : 10-2010-0053835
- 패밀리정보 : 없음
- 패키징특허 : 없음

● 보유 기관 : 한국표준과학연구원

## 기술개요

- 화학 증착법에 있어서, 전구체의 증기압을 실시간으로 측정하여 박막의 질적 특성을 높이기 위한 측정 시스템 및 방법에 관한 기술
- 활용처 : 반도체 제조 공정 분야

### 기존 한계점

- 반도체 공정을 위한 화학 증착법에 증착되는 박막의 질적 특성을 높이기 위한 기술이 필요함
- 전구체의 대부분이 공기중에 노출되는 경우 인화성 특징으로 다루기 어려움
- 화학 증착 장비에 탑재된 전구체의 증기압에 대한 실시간 모니터링이 필요한 실정임

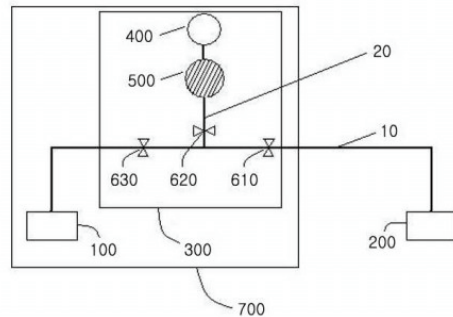
### 기술 차별점

- 온도변화에 따른 전구체의 석출 및 전구체의 미소 탈기에 따른 압력 변화의 가능성을 현저하게 줄일 수 있음
- 증기압 관련 열역학적 데이터는 화학 증착법을 사용하는 반도체 제조공정 등에서 유용하게 활용할 수 있음

### 세부 내용

- 주유로의 압력을 측정하기 위한 증기압 측정장치를 포함
- 주유로에서 분기유로로 분기되는 분기점 후단에 설치되는 제1 밸브와 분기유로에 설치되는 제2밸브를 포함
- 시료의 향온이 유지되도록 단열 격벽체의 내실에 밀봉되어 배치됨

### 대표 이미지



wips



문의처

- 국가과학기술연구회 공동TLO마케팅사무국 엄예지 선임연구원
- T. 042-862-6986 E-mail. yjeum@wips.co.kr